

無料招待券 申込み受付中! 詳しくはこちら → www.jpccashow.com

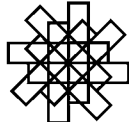
JPCA 2011 Show

第41回国際電子回路産業展
41st International Electronic Circuits Exhibition

主催: 社団法人日本電子回路工業会
Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association

■構成展示会

- 2011 プリント配線技術展 PWB Technology 2011
- 2011 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module Japan 2011
- 2011 機器・半導体受託生産システム展 EMS Japan 2011



ラージエレクトロニクスショー2011

共催: 社団法人日本電子回路工業会・半導体産業新聞社(産業タイムズ社)
Co-Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
The Semiconductor Industry News (Sangyo Times, Inc.)

Large Electronics Show 2011

■構成展示会

- 2011 プリントエレクトロニクス技術展 PE Technology 2011
- 2011 部品・MEMS/デバイス産業総合展機材展 Device Engineering 2011
- 2011 LED/OLED 応用技術展 Solid State Lighting 2011



2011 マイクロエレクトロニクスショー

第25回 最先端実装技術・パッケージング展
25th ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION

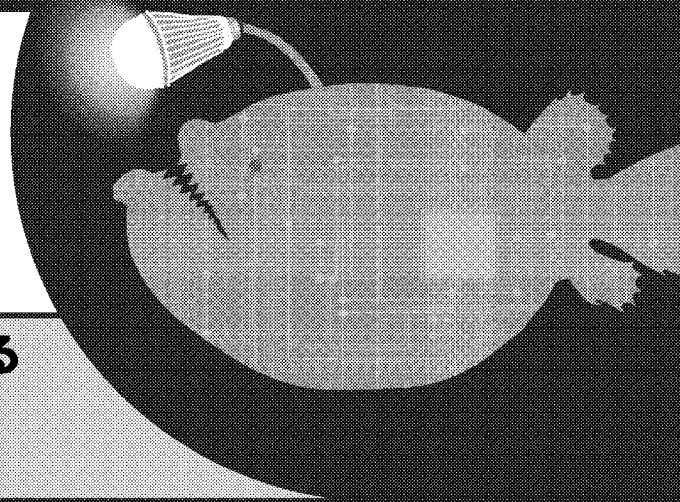
主催: 社団法人エレクトロニクス実装学会
Sponsored by: JIEP Japan Institute of Electronics Packaging



JISSO PROTEC 2011

第13回 実装プロセステクノロジー展
13th Jisso Process Technology Exhibition

主催: 社団法人日本ロボット工業会
Sponsored by: JRA Japan Robot Association (JARA)



最先端機器を支える電子回路・電子実装技術を誇るリーディングカンパニーが世界中から集結! 新たな潮流がここから生まれます。

2011年 6月1日(水)~3日(金) 10:00~17:00

東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

■同時開催 ものづくりフェスタ2011

- 日 時: 2011年6月1日(水)~3日(金)
- 場 所: 東6ホール内 プレミアムステージ
- 主 催: 社団法人日本電子回路工業会
- 特別協力: 半導体産業新聞(株)産業タイムズ社、一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、社団法人組込みシステム技術協会(JASA)、EMSONe
- 組込みシステム技術協会(JASA)特別講演・展示
- 電子機器分解セミナー・展示
- 半導体産業新聞主催「夢をカタチに」次世代アプリ開発支援のセミナーと特別展示
- EMSONe主催「EMSONe/ODM最前線セミナー」
- 実装体験コーナー

■基調講演プログラム (有料)

主 催: (株)日本電子回路工業会・(株)エレクトロニクス実装学会・(社)日本ロボット工業会
特別協力: 半導体産業新聞(株)産業タイムズ社

(2011.5.6現在) ※都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。予めご了承下さい。

6月1日(水)	6月2日(木)	6月3日(金)
テーマ: グローバルトップ戦略の動向 基調講演 1 「電気自動車時代のEVが創る未来〜EVが求める電子回路技術〜」 日産自動車(株) 電子技術開発本部 エキスパートリーダー 二見 徹氏 基調講演 2 「LTEが近く未来の通信機器(仮)」 (株)NTTコム 取締役常務執行役員 研究開発センター所長 小森 光彦氏 基調講演 3 「日本のモノづくりデジタルの現状と未来〜実装技術の産業を中心に〜」 一般社団法人カメラ映像機器工業会 プロダクト推進部 委員長 後藤 哲郎氏 2011展示会フェスティバルセレブレーション(実況中継) 第7回JPCA賞(アワード)授賞式、第3回JPCAデザインアワード授賞式 第2回JPCA賞授賞式	テーマ: CPUコアとパワーエレクトロニクス動向 基調講演 4 「ARMのビジネスモデルの意味」 ARM(株) 代表取締役社長 西嶋 貴史氏 基調講演 5 「世界スマートシティが望む技術とアプローチ」 日本IBM(株) 公共サービス事業部 部長 今野 博氏 基調講演 6 「スマートグリッドを変えるパワーエレクトロニクス」 三菱電機(株)システム事業部 スマートグリッド事業部 総務部長 奥山 仁平氏 基調講演 7 「次世代2次電池・燃料電池のアプリケーションと日本のエネルギー政策を考える」 HSI Supply Japan KK. Japan Research Principal Analyst 大山 隆氏	テーマ: ラージエレクトロニクス応用動向と特別招待講演 基調講演 8 「次世代照明LED/OLED海外動向」 (依頼中) 基調講演 9 「Fully Roll-to-Roll Gravure System for Printing 13.56 MHz Operated 32 Bit RFID Tags」 Oki Print Group Co., Ltd. President and Chief of Research & Development Division Roll-to-Roll Printed RFID Tags, Sanjio National University 特別講演 10 「小型化と高信頼性」は必ずしもトレードオフではない JARA 事務局 吉光 賢治氏

※上記記事全文掲載を更新しておりますので、展示会WEBサイト <http://www.jpccashow.com> でご確認ください。



本展示会では2011年「東日本大震災」による被災地域の早期復興を願う応援メッセージを含め「がんばろう!! 日本」をスローガンに掲げ開催致します。
本展示会では、節電に伴い、「クール・ビズ」を推奨しております。
ご出展者の方へにつきましても、「クール・ビズ」で接客させていただく場合がございますことを予めご了承ください。

■JIEP主催最先端実装技術シンポジウム

本年度は、展示会の機能別展示と連動し、「サーマル マネジメント」「高速高周波伝送」「グリーンエネルギー」「ラージエレクトロニクス〜プリンテッドエレクトロニクス」「次世代モジュール PKG」「グリーン MEMS」などのテーマを深掘りした第一人者が発表予定。
詳細は www.jpccashow.com をご覧ください。

(2011.5.6現在) ※プログラムは、変更される可能性がございますことを予めご了承下さい。

6月1日(水) A会場	6月1日(水) B会場
セッション1A1 9:30~12:30 デバイス性能を最大限に引き出すサーマルマネジメント技術 I	セッション1B1 9:30~12:30 本格導入が近づく光インタコネクト技術
セッション1A2 13:30~16:30 デバイス性能を最大限に引き出すサーマルマネジメント技術 II	セッション1B2 13:30~16:30 高速デジタル回路のためのSI/PI解析およびLPB相互設計技術
6月2日(木) A会場	6月2日(木) B会場
セッション2A1 9:30~12:30 今から重要なグリーン革命、これを支える最新テクノロジ	セッション2B1 9:30~12:30 最先端技術で世界をリードするカーエレクトロニクスの最新動向
セッション2A2 13:30~16:30 進歩著しいグリーンエネルギーとしての最新電池技術	セッション2B2 13:30~16:30 新分野応用に広がるプリンタブルエレクトロニクス
6月3日(金) A会場	6月3日(金) B会場
セッション3A1 9:30~12:30 次世代3次元パッケージに対応する新実装技術	セッション3B1 9:30~12:30 実装の高機能化と高性能化を期す新規材料の開発の現状
セッション3A2 13:30~16:30 コストパフォーマンスに優れたパッケージング技術の新潮流	セッション3B2 13:30~16:30 MEMS/NEIMSを活性化させるキー技術

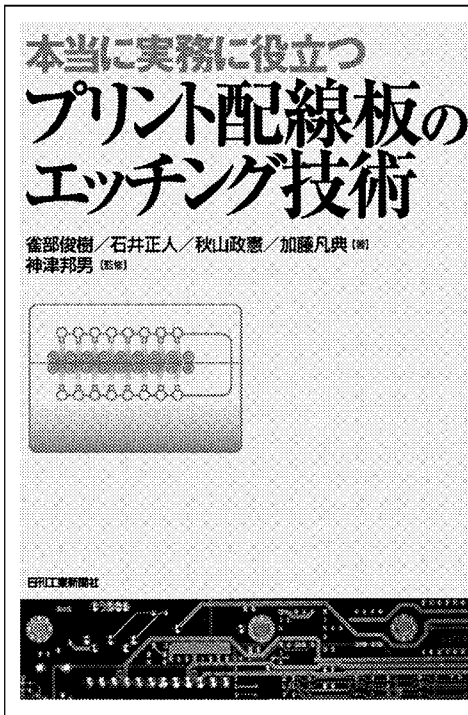
■お問い合わせ先 ▶ 運営事務局: JPCA 社団法人日本電子回路工業会 〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 e-mail: show@jpcca.org www.jpccashow.com



よくわかる プリント配線板の できるまで 第3版

高木 清著
●A5判 ●定価1890円(税込)

プリント配線板について、パターン設計からエッチング、積層、めっきといった製造工程から検査工程までを、具体的な図解によって、順を追って丁寧に説明した定本の第3版。「プリント配線板とは何か」からはじまり、「最新の技術動向」までを紹介した完全版。



本当に実務に役立つ プリント配線板の エッチング技術

雀部俊樹・石井正人・秋山政憲・加藤凡典著
神津邦男 監修
●A5判 ●定価2730円(税込)

プリント配線板の製造工程中、基板の上に回路を形成するエッチング技術は最重要技術。本書はこのエッチング技術について、貴重な資料や、実際のエッチングトラブルなども含めて詳しく丁寧に紹介した本。

プリント回路技術 用語辞典 第3版

プリント回路技術用語辞典編集委員会編
●B6判 ●定価3,150円(税込)

プリント配線板の設計・製造から部品実装・検査に至るまで、現場で使われる専門用語を解説した定番の用語辞典。第3版では新たに200語を超える用語を追加して、より充実した内容になっている。

入門 電子部品の実装技術ノート

塚田 裕・青木正光編著
●A5判 ●定価2,730円(税込)

超小型パッケージやフリップチップ実装などの最新の実装手法をはじめ、高信頼性、環境配慮など、現場が抱える課題に即した表面実装技術の諸テーマについて、実装設計、はんだ実装、先端パッケージなど、5分野45テーマに分けて解説した実務対策書。

よくわかる プリント板実装の 高速・高周波対策

井上博文著 ●A5判 ●定価1,995円(税込)

プリント板実装の高速・高周波対策について豊富な図面と共に解説した本。部品選定からベアチップ実装、LSIパッケージ、チップ部品の実装まで、高速対策および高周波対策について丁寧にわかりやすく紹介している。

標準 マイクロソルダリング技術 第3版

社団法人 日本溶接協会マイクロソルダリング教育委員会編
●B5判 ●定価3,780円(税込)

日本溶接協会が実施するマイクロソルダリング技術者、マイクロソルダリング技術インストラクター、マイクロソルダリング技能者の認定試験および検定試験のテキスト。第3版では新たに基板設計に関する項目を追加し、現在の技術に即した内容に改訂した。

入門 プリント基板の回路設計ノート

高木 清・安食弘二編 サークットネットワーク・(株)図研著
●A5判 ●定価2,730円(税込)

プリント基板の回路設計で抱える課題と基礎知識を紹介した本。回路設計、熱対策、CAD、信頼性試験など、現場が抱える40点以上の様々な問題点について、その対策や手法を紹介している。

図解でナットク! 二次電池

基礎と応用技術の最前線

小林哲彦・宮崎義憲・太田 璋編著
●A5判 ●定価2,310円(税込)

これまで二次電池産業は日本が世界を牽引してきたが、近年、海外勢の追い上げが厳しく、国際間で新型電池開発競争が激化している。本書は、二次電池を産業的に利用する立場の読者に向けて、各種二次電池の原理、特徴、最新の活用例、今後の展開などを図解で解説する。

JPCA 2011 Show

第41回国際電子回路産業展

■6月1日(水)~6月3日(金)
■東京ビッグサイト
日刊工業新聞社 出展ブース
東5ホール 5J-01 東4ホール 4D-03
展示・即売致します。ぜひお立ち寄り下さい。

あなたの仕事に役立つ理工学書・ビジネス書・技術雑誌

専門オンラインショップ **Nikkan Book Store** <http://pub.nikkan.co.jp/>

ご注文は書店または添付FAX申込書で弊社出版局販売・管理部までお申し込み下さい。

日刊工業新聞社 出版局販売・管理部 〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1
TEL 03(5644)7410 FAX 03(5644)7400
お申し込みの際、複写(コピー)されたものをFAXされますようお願い致します。 ※弊社にお申し込みの方は送料を無料とさせていただきます。

FAX申込書 03(5644)7400

〒		TEL:		FAX:	
ご住所:		会社名:		部署:	
				注文者名:	
日刊工業新聞社 発行	冊数	金 額	日刊工業新聞社 発行	冊数	金 額
よくわかるプリント配線板のできるまで 第3版			入門 電子部品の実装技術ノート		
プリント配線板のエッチング技術			入門 プリント基板の回路設計ノート		
プリント回路技術用語辞典 第3版			よくわかるプリント板実装の高速・高周波対策		
標準マイクロソルダリング技術 第3版			図解でナットク! 二次電池		
合 計					